

メカトロニクス事業部門



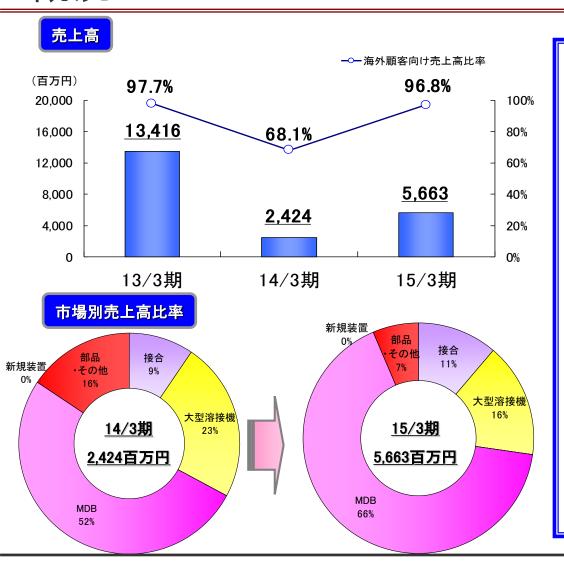
メカトロニクス事業部

SG:システム機器

(SG:システムグループ)



概況



♦POINT**♦**

◇15/3期 決算概要

MDBが前期からの一服感を脱したことに加えて、 自動車部品向け大型溶接機が好調に推移し、また 光通信関連市場の活況が続き光半導体用小型 溶接機も計画以上に伸長したことから、売上高は 前期比133.6%増の56億6千3百万円(総売上高の 15.4%)となりました。

◇16/3期 計画概要

- ・小型/中型パネル用MDB量産機の市場拡大 =中国ローカルメーカーへの拡販
- ・大型新製品(真空ソルダリング・システム)の本格販売 =大型機MP2の本格販売 =小型機(Mini)の上市とシリーズ販売
- 自動車部品向け大型溶接機拡販
- ・ 光半導体用小型自動溶接機の売上確保
- ・大型新製品(第4の柱以降)の開発推進
- ・中国メンテナンス体制の維持管理

通期売上高計画40億円

SG製品群



重点製品とターゲット市場

1. MDB

小中型パネル用LCシリーズと

新工法C2L

型式:LC4

→中国ローカル市場

2. 真空ソルダリングシステム

パワー半導体市場

4. 光半導体用小型溶接機

型式:VS2

3. 大型溶接機



→自動車関連市場

型式:P-14A



アジア光通信市場

重点製品1-1 MDB

MDBロードマップ





重点製品1-2 MDB

LCシリーズ



小中型パネル用MDB



- ◇ロット切り替えが容易
 ◇4~8インチパネルに対応
 - 多

多品種小中ロットに最適

◇貼合せポジションを2~4箇所の間で変更可



生産量に応じた装置選択を実現

◇小型、低価格

重点製品1-3 MDB

新工法C2L



LCM対応C2L装置

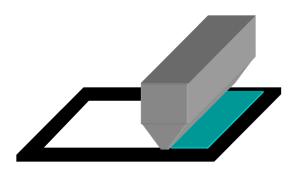
新工法装置を市場へ投入

C2L (Coating Cure Lamination)装置

- ●スリットコート方式による面塗布採用
- ●面塗布及び仮硬化によるはみ出し・膜厚特性向上



スリットコート方式



大型基板や剛性が低い基板 (LCDモジュール等)に最適

重点製品1-4 MDB

MDB市場

2013実績

2014







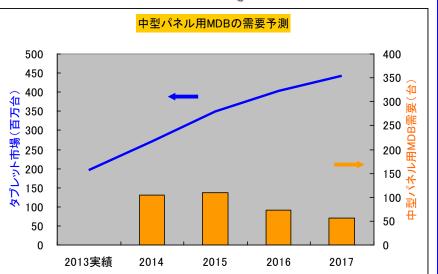
型式:LC4

小型パネル用MDBの需要予測 1,800 400 1,600 350 ートフォン市場(百万台) 1,400 300 1,200 250 1,000 200 800 150 600 100 400 50 200 0

2015

2016

2017



2014/5/29版

スマートフォンとタブレットの世界市場予想データを基に、 小型パネル(2~5")用と中型パネル(5~10")用MDBの需要を予測

重点製品2-1

大型新製品:真空ソルダリングシステム

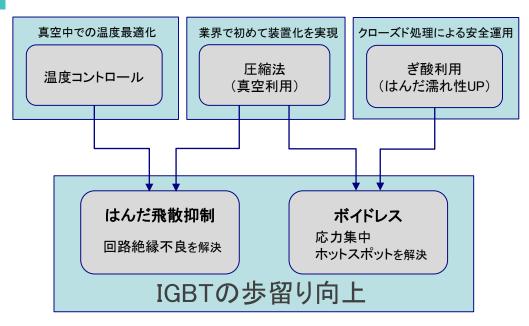


パワーデバイス用次世代半田付け装置

ぎ酸還元と真空利用によりボイドレスを実現(はんだ飛散も同時抑制)

還元力の高いぎ酸をクローズド処理で安全に運用

真空プロセスでのスムーズな温度コントロール





IGBT用途: ・自動車(HV, EV) ・鉄道車両駆動 ・家電インバータ ・産業用MW用モータ

重点製品2-2





装置ラインナップ

真空ソルダリングシステム Mini

Miniは研究用途向けの小型装置で、 ギ酸還元を評価するために最適な一 台です。

また、オプションを追加することによって用途の幅が広がります。

装置寸法 W850×D450×H750



真空ソルダリングシステム VS2

VS2 は研究用途から少量生産に適した コンパクトバッチモジュールです。 ワークの出し入れに便利な自動搬送 機構を標準で装備しています。

装置寸法 W850×D850×H1460

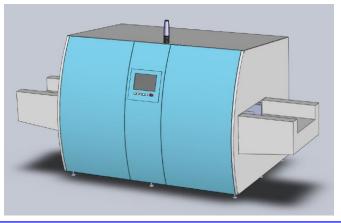


2015年リリース予定

真空ソルダリングシステム MP2

MP2 は加熱と冷却を独立させた2チャンバ仕様の 量産設備です。

処理スペースはW380 x D310 x H100mm と大型 ワーク搭載まで可能です。



重点製品2-3 真空ソルダリングシステム

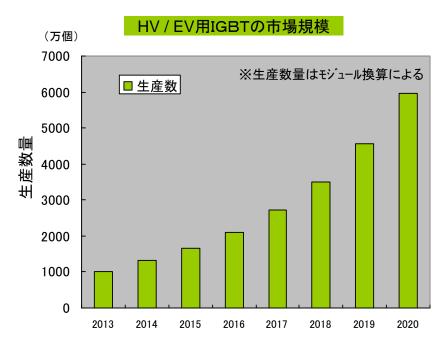






型式:VS2

真空ソルダリングシステム市場



HV/EVの市場拡大とともに、IGBTの大幅な需要増が期待されます。



20台~40台以上/年程度の新規導入の他に、既存機からの更新が見込まれます。(弊社大型量産機換算による)

2014/7/22版

HV/EV用IGBTの世界市場予想データを基に、 真空ソルダリングシステムの今後の需要と潜在需要を予測

重点製品3

コンデンサ式大型溶接機+リングマッシュ方式



電子ビーム代替として複数の自動車関連メーカーで採用拡大

◇用途:自動車やオートバイなどの同軸駆動系部品の溶接

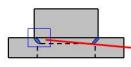
コンデンサ式大型溶接機



リングマッシュ



コンデンサのエネルギーを瞬時に放電し短時間大電流で溶接





リングマッシュ 接合部断面

電子ビーム溶接と比較して、

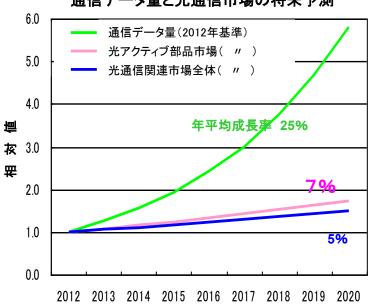
- 歪みが少ない
- ・消耗品が少ない
- 条件出しが簡単
- ・ランニングコスト1/5以下 (車用駆動系部品の場合)

重点製品4 光半導体用小型溶接機



光通信関連市場向け

通信データ量と光通信市場の将来予測



- ・通信データ量:米シスコシステムズによる予測
- ・光通信関連市場全体・光アクティブ部品市場: 「2013光通信関連市場総調査」富士キメラ総研



生産・販売拠点

